

公益社団法人 精密工学会主催 第360回講習会

「スマホ新時代のガラス加工と高密度実装

—新しいガラス材料とその成形, TSVによる積層3次元実装—

開催期日：平成25年 6月18日(火)

申込締切：平成25年 6月11日(火)

主催：公益社団法人 精密工学会 企画：事業部企画第2グループ

協賛(予定)：RP産業協会/SME東京支部/エレクトロニクス実装学会/応用物理学会/大田区産業振興協会/科学技術振興機構(JST)/計測自動制御学会/研削砥石工業会/研磨布紙協会/自動車技術会/全日本プラスチック製品工業連合会/素形材センター/ダイヤモンド工業協会/超硬工具協会/電気加工学会/砥粒加工学会/日本オプトメカトロニクス協会/日本MID協会/日本金型工業会/日本機械学会/日本木型工業会/日本金属学会/日本金属プレス工業協会/日本光学測定機工業会/日本工具工業会/日本工作機械工業会/日本合成樹脂技術協会/日本材料学会/日本精密機械工業会/日本セラミックス協会/日本塑性加工学会/日本鍛造協会/プラスチック成形加工学会

★協賛団体にご所属の方は会員価格にてご参加いただけます。

爆発的に普及したスマートフォンやタブレットPCの小型化や高性能化を実現するために多くの取り組みが行われております。この中でも表示デバイスにはガラスが不可欠であり、高い耐久性や生産性を実現するために新しい加工技術が提案されております。また、半導体では、微細化だけではなく、一層の高密度化・高性能化を可能にする積層3次元実装技術が着目されております。そこで、本講習会では、このスマートフォンに関連する「ガラスの加工」と「積層3次元実装」に関しての概要、近年の動向、要求される技術、新たな取り組みなどについて解説を頂きます。広範な技術が必要とされるため、関連業界だけでなく、幅広い分野の方々の参考になるかと思っております。皆様のご参加をお待ちしております。

日時：平成25年6月18日(火) 10時00分～16時50分(名刺交換会 交流会17時00分～19時00分)

会場：東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館2階1206室(〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番)

* 北千住駅(JR常磐線, 東京メトロ(日比谷線, 千代田線), 東武伊勢崎線, つくばエクスプレス)下車徒歩約1分

* 関屋駅(京成本線)下車徒歩約7分, 牛田駅(東武伊勢崎線)下車徒歩約7分

* 会場 URL: <http://web.dendai.ac.jp/access/tokyosenju.html>

※当日は1号館(1階にItalian tomato Jr.がある建物)の受付にて入館証を受け取り、お入りください。

司会：比田井洋史(千葉大学), 松井伸介(千葉工業大学)

司次：(予定)

時間	題目	内容	講師
10:00～10:05	挨拶		
10:05～11:05	ガラス加工の総論と切削技術	ガラスの加工技術の概要を述べ、各加工技術の用途と特長について述べる。また、ガラスの切削を取りあげ、金属切削との違いを示すとともに、ガラスの切削技術に対するポイントを示す。	東京電機大学 松村 隆
11:05～11:55	スマートフォン向け化学強化カバーガラス成形技術・装置の開発	スマートフォン向けタッチパネル形状は、現状は平面形状が主流であるが、意匠性等を考慮して外周を湾曲させる形状に成形させるニーズが高まっている。本講演では、化学強化ガラスの加熱・プレス成形に関する量産技術と、その成形事例について紹介する。	東芝機械株式会社 松月 功
11:55～13:00	昼食		
13:00～13:40	超薄板ガラスの紹介	軽くてフレキシブルな、また、エネルギー・環境面で優れた特性を持つ、新しい材料として超薄板ガラスが注目されている。本講演では、当社で製造を行っている超薄板ガラスについて、その各種特性等を紹介する。	日本電気硝子株式会社 伊東 翔
13:40～15:00	TSVによる3D実装技術とスマートフォンへの適用	半導体LSIの高密度化、高性能化を実現するTSV技術の実用化が進行している。真空物理加工、高性能有機材料、精密研削等を駆使するTSVの作成技術とチップ積層技術について紹介する。TSVをスマホ用半導体に適用すると画像表示の高速化、電力消費の低減が可能になる。	エレクトロニクス実装学会 傳田 精二
15:00～15:10	休憩		
15:10～16:00	TSV ウェハ薄層化プロセス技術	TSV ウェハの薄層化プロセスの概要と、その実現に必要な要素技術の最新情報を報告する。特に研削においてはCuとSiの同時研削を実現するための新研削法、Cuビアの平坦研磨や突き出し研磨の現状について述べる。	株式会社岡本工作機械製作所 山本 栄一
16:00～16:50	システムインテグレーション対応インターポーザ加工技術	スマートフォン、タブレット向けのインターポーザ加工技術の最新技術の紹介と、インターポーザ加工技術を利用したシステムインテグレーション事例に関し、特性改善結果をまじえて解説する。	大日本印刷株式会社 相楽 秀次
17:00～19:00	名刺交換会 交流会 (参加費無料)		

定員：60名(先着順で定員になり次第締切ります)

参加費：会員(賛助会員および協賛団体会員を含む)20,000円、非会員30,000円【会員・非会員とも講習会テキスト代含む】

学生会員 無料(ただし、講習会テキストご入用の場合は、4,000円をご負担ください)

学生非会員 6,000円(講習会テキスト代含む)

*参加費・講習会テキスト代とも消費税を含みます。

資料：講習会テキストのみ、または聴講者で2冊以上ご希望の場合、1冊4,000円

申込方法：ホームページ(http://www.jspe.or.jp/event/koshukai_form.htm)からお申込み下さい。

申込先：公益社団法人 精密工学会(〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-9 九段誠和ビル2F, 電話03-5226-5191, Fax03-5226-5192)